



牛人已开启手机号隐私保护

您可使用BOSS直聘APP扫描二维码联系Ta

dc1763beac4e89b81HJ90tq1EiBYxoi8UvOaWOGnmfD\$NzRm2Q~

黄筱辉



男 | 31岁 904016297@qq.com

9年工作经验 | 硬件工程师 | 期望薪资：30-40K | 期望城市：深圳

个人优势

大学毕业后入职柔宇科技，快速熟悉行业技术规范和标准化、流程化的工作体系，参与多款柔性屏的开发设计工作，与多部门高效协作，保障项目按时高质量交付。

后加入星猿哲科技，专注工业相机开发，主导多款相机研发项目，熟练使用赛灵思、树莓派开发平台；熟悉CMOS硬件设计及MIPI、USB等常用接口开发，具备标准电路设计能力。

工作经历

卡莱特科技股份有限公司 硬件

2025.06-至今

- 负责LED显示控制硬件研发，参与接收卡、发送卡、主控整机全流程开发调试，熟悉大屏显示信号传输整套架构。
- 参与公司AI算力板卡硬件项目，完成硬件功能验证、链路调试与性能优化，掌握边缘AI推理硬件开发流程。
- 独立开展硬件故障定位、问题闭环，联动软件、测试团队迭代优化产品，保障多代板卡顺利量产落地。

星猿哲科技（深圳）有限公司 硬件工程师

2021.05-2025.06

- 激光振镜相机电路开发：主导激光振镜相机电路全流程设计，从方案规划到调试落地；依据客户反馈与项目需求，完成多轮产品迭代，提升响应速度与稳定性。
- DLP/散斑相机协作开发：参与DLP/散斑相机项目，协助硬件架构设计与关键元器件选型，攻关技术难点，保障产品按时交付。
- FPGA平台迭代优化：负责FPGA平台设计，完成架构搭建与功能开发；结合技术趋势，对平台进行升级，优化数据处理效率。
- Cmos相机硬件设计：承担Cmos相机硬件全流程开发，涵盖电路设计、调试与测试，提升图像质量与功耗表现，满足市场应用需求。

深圳市柔宇科技股份有限公司 电子工程师

2017.07-2021.04

- 项目可行性评估与方案设计：依据市场动态及客户需求，全面评估新项目可行性，主导驱动芯片兼容方案设计，为公司新项目立项提供技术支持。
- OLED电路设计与开发：运用Cadence完成OLED Panel原理图及外部驱动电路图绘制，推动项目顺利进入开发阶段。
- 模组调试与性能测试：负责模组驱动程序调试及产品性能测试，输出稳定固件，保障产品性能达到预期标准。

4. 显示问题分析与改善：针对客户端及厂内显示性能问题，深入分析根本原因，输出专业报告，协同团队制定改善措施，推动问题高效解决。

5. 电源IC技术平台建设与开发：搭建AMOLED Power IC验证平台，完成多家供应商产品测试评估及适配；并参与AMOLED Power ASIC开发。

项目经历

机械臂项目 硬件工程师 2024.07-2025.04

电磁阀控制板，激光雷达交换机板开发

- 电路开发：协同嵌入式工程师选择主控芯片，负责产品电路架构规划与设计，开展元器件市场调研及选型工作。
- 硬件调试：协同Layout工程师完成PCB布局布线，提供技术支持与设计优化建议；独立承担单板硬件调试工作，确保硬件性能达标。

CMOS相机开发 硬件工程师 2023.11-2024.06

- CMOS电路方案设计：依据项目需求选定CMOS器件，系统评估并完成配套外围器件选型，确保电路方案的兼容性与稳定性。
- 硬件测试验证：对CMOS电路模块进行功能测试、性能验证及可靠性测试，通过信号完整性分析、电源纹波检测等手段，快速定位并解决硬件异常问题，保障产品质量达标。

FPGA平台开发 硬件工程师 2023.09-2024.05

- FPGA电路开发：主导赛灵斯-3EG/5EG电路架构规划与设计，开展元器件市场调研及选型工作，基于项目需求完成原理图绘制，从源头保障电路方案的可行性与创新性。
- 跨职能协同与硬件调试：深度协同Layout工程师完成PCB布局布线，提供技术支持与设计优化建议；独立承担单板硬件调试工作，确保硬件性能达标。
- 核心项目底板升级验证：负责激光振镜原理图设计及layout，并完成验证工作，结合产品迭代需求优化电路方案，完成多轮测试与性能调优，项目完成最终量产。

激光振镜/DLP 相机V2 硬件工程师 2022.09-2023.08

- 电路设计：结合行业前沿技术趋势，完成电路架构的全面重新规划与设计，优化信号传输路径与模块布局，提升系统集成度与稳定性，为产品性能升级奠定基础。
- FPGA载板研发：选定5EV控制芯片，围绕K26技术平台，开展载板的调研、选型及方案设计工作，匹配芯片性能与功能需求，完成多层高速PCB设计，确保板卡间高效协同与信号完整性。
- demo样机到产品：基于载板设计方案，独立完成demo样机的搭建、调试及优化工作，通过系统性测试与参数调整，实现样机功能稳定运行，加速产品原型验证及产品升级。
- DLP相机开发测试：深度参与DLP相机项目开发，并依据激光振镜相机为参考，完成硬件架构设计与关键电路模块搭建，主导核心元器件选型及电路原理图绘制，保障硬件系统稳定可靠，推动项目高效推进。

1. 市场产品调研：开展市场信息调研与竞品分析，结合行业趋势与客户需求，完成demo产品电路架构设计。
2. 核心器件选型：针对产品核心功能需求，完成激光、驱动模块及振镜等关键器件的选型评估，通过技术验证与成本优化，选定高适配性器件。
3. 硬件开发与调试：独立完成电路原理图与PCB Layout设计，严格把控设计规范；协同团队完成demo样机搭建与调试，实现产品从设计到落地的转化。
4. 电路板集成与结构协同优化：配合结构设计需求，推进电路板合板方案落地，通过电路布局优化与信号整合，有效缩短机线长度，实现产品结构紧凑化，降低装配复杂度与生产成本。
5. 相机升级优化：主导单目相机到双目相机的电路升级改造，重新设计适配电路架构，实现硬件无缝替换，提升相机成像精度，满足高性能需求。
6. 嵌入式开发：基于STM32平台完成激光、振镜驱动程序及温度控制程序开发，自主设计PID控温电路，实现高精度温度闭环控制，保障核心部件稳定运行，提升设备工作可靠性。

2"DOE验证项目

电子工程师

2020.10-2021.03

1. ASIC电路开发：配合面板电路的特殊架构与需求，精准匹配芯片特性与功能需求，完成外部驱动电路的方案设计与优化。
2. 模组全流程测试与数据管理：主导模组驱动程序调试工作，通过系统性测试验证程序性能；搭建标准化数据采集体系，高效收集、分析产品运行数据，为性能优化与迭代提供关键决策依据。

7.8"/7.2"柔性屏项目

电子工程师

2020.01-2021.03

1. OLED电路设计：运用专业电路设计工具（如Cadence），完成OLED Panel原理图及外部驱动电路图绘制，严格把控设计规范与技术参数，确保电路方案的可靠性与稳定性。
2. 模组协同验证：主导模组驱动程序调试工作，深度配合改版ASIC验证流程，通过系统性测试与参数优化，精准定位并解决程序与硬件适配问题，保障模组性能达标，推动产品迭代升级。
3. 电源技术平台开发：独立设计外部分离式power验证平台，完成多轮测试验证；并主导AMOLED Power ASIC开发项目。
4. 跨团队合作：深度参与RA及客户端异常问题分析，运用系统化故障排查方法定位根本原因，主导技术研讨会并提出优化方案，推动问题闭环解决，提升产品可靠性与客户满意度。

7.8"DOE项目

电子工程师

2019.09-2020.01

1. 项目流程把控：深度评估项目可行性，主导设计驱动芯片兼容方案。
2. OLED电路设计与开发：运用Cadence等专业工具，独立完成OLED Panel原理图及外部驱动电路图设计，保障电路设计的准确性与可靠性，推动项目进入高效开发阶段。
3. 模组调试与问题攻关：负责模组驱动程序调试工作，协同ASIC验证流程，系统性开展产品性能测试。针对调试与测试中出现的技术问题，快速定位根因并提出有效解决方案，确保产品性能达标，顺利完成交付。

一代7.8"折叠屏项目

电子工程师

2018.06-2019.08

1. FPC 第二供应商导入：主导FPC第二供应商导入工作，完成技术方案审核及兼容性测试，建立稳定备用供应链，降低单一货源风险，保障产品供应稳定性。
2. 模组驱动程序调试：负责模组驱动程序全流程调试，精准定位并解决程序运行中的异常问题，优化驱动性能，确保模组功能稳定运行，助力产品顺利通过测试与交付。

教育经历

湖南大学 本科 电子科学与技术

2013-2017